

Embedded-Systeme auf Basis der Intel-Atom-x6000E-Prozessoren

Syslogic kündigt Elkhart-Lake-basierte Industrie-PCs an

Syslogic kündigt für Anfang 2021 neue Industriecomputer auf Basis der Intel-Atom-x6000E-Prozessoren (Elkhart-Lake) an. Syslogic plant Embedded-Computer speziell für Fahrzeug-, IoT- und Bahnanwendungen.

Ende September hat Intel Atom die langerwartete x6000E-Serie (Elkhart Lake) vorgestellt. Die neue Prozessorserie tritt die Nachfolge der 2016 präsentierten E3900-Serie (Apollo Lake) an. Mit ihrer 10nm-Technologie ebnet die Intel-Atom-x6000E-Serie den Weg für die künftige Embedded-Anwendungen.

Fit für künftige Edge-Anwendungen

Im Vergleich zum Vorgänger stellt die x6000E-Serie je nach Version die doppelte Grafikleistung bereit. Auch die Multi-Thread-Leistung, also die gleichzeitige Nutzung aller Prozessorkerne, soll sich gemäß Intel Atom um bis zu 50 Prozent gesteigert haben gegenüber dem Vorgänger - dies bei ähnlich tiefer Leistungsaufnahme. Die neuen Prozessoren arbeiten je nach Version mit zwei oder vier Prozessorkernen und unterstützen mit Time-Sensitive Networking (TSN) Echtzeitanwendungen.

Weitere Neuheiten

Es stehen bis zu 32 GB Arbeitsspeicher mit integrierten Error Correcting Code (ECC) bereit. Zu weiteren Neuheiten gehört die Integration von CAN FD im Prozessor. Secure Boot SGX wird ebenfalls unterstützt. Weiter bietet Intel Functional Safety (FuSa) gemäß ISO-13849-Anforderungen.

Elkhart-Lake dient als Basis für neue Syslogic Embedded-Computer

Als führende Embedded-Anbieterin hatte Syslogic die Möglichkeit, die neue Prozessorgeneration frühzeitig in ihre Trägerboards zu integrieren.

Als eines von wenigen europäischen Unternehmen fertigt Syslogic ihre Boards auf eigenen Bestückungslinien selbst. Bereits werden erste Prototypen der neuen Trägerboards ausgiebig getestet. Die Präsentation der x6000E-basierten Embedded-Computer plant Syslogic für das erste Quartal 2021.

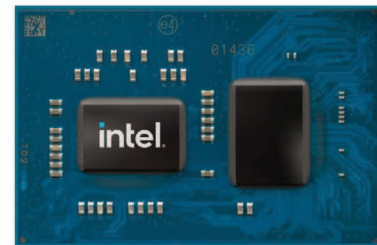
Michael Jung, der die neuen Syslogic Industriecomputer als Product Manager verantwortet, erklärt: „Wir werden eine Reihe neuer Produkte lancieren, die sich für Bereiche wie Mobile Computing, Rugged Computing oder Railway eignen werden. Wie alle Embedded-Systeme von Syslogic sind auch die neuen für den Dauereinsatz unter Extrembedingungen ausgelegt. Geplant sind

Versionen für den erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C.“

Ideale Hardware-Plattform

Syslogic wird mit den x6000E-basierten Industriecomputern die ideale Hardware-Plattform für künftige IoT-Anwendungen (Internet of Things) bieten. Einerseits sollen bestehenden Kunden mit der neuen Produktgeneration ausgerüstet werden, andererseits will Syslogic ihre Marktstellung insbesondere im Bereich Mobile- und Rugged-Computing weiter ausbauen.

■ Syslogic GmbH
info@syslogic.de
www.syslogic.de



das BIOS in weiten Bereichen eingestellt werden kann. Zur Standardausstattung des SmartMOD gehört ein Multi-Display-Port (DDI/VGA und DP). Zahlreiche Status-LEDs erleichtern Inbetriebnahmen

und eventuelle Fehlersuche. Ausgestattet werden kann der SmartMOD maximal mit 32 GB DDR4-RAM. Ein erweiterter Einsatzbereich von -20 bis +60 °C ist möglich. „Das mSATA-2,5“-Laufwerk

lässt sich nach dem Lösen zweier Schrauben wechseln,“ freut sich Johann Enthammer, der bei F&S Bondtec die Entwicklung zuständig, über den servicefreundlichen Aufbau des Industrierechners.

Arbeitsteilung

Neben der Lizenzierung übernimmt EFCO auch vorbereitende Arbeiten, wie das Aufspielen eines von F&S bereitgestellten Images. „Für uns war die Partnerschaft mit EFCO genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt“, fasst Enthammer die Erfahrungen mit der Deutschland-Tochter der taiwanesischen IPC-Spezialisten zusammen. „EFCO hat ein gutes Produkt, hat uns beim Design-In solide unterstützt, hält uns Systempflege und Lizenzierung vom Leib und gibt uns damit Ressourcen frei, um unsere Produkte weiter zu entwickeln und gemeinsam mit unseren Kunden neue Applikationen anzugehen.“ ◀